

长电科技绍兴项目启动 中芯绍兴项目通线投片

11月15日下午，绍兴举行长电科技绍兴项目签约仪式。国家发改委国际合作中心副主任崔琳，绍兴市领导马卫光、盛阅春、谭志桂、魏伟、徐国龙、邵全卯，长电科技总顾问张文义，长电科技董事、中芯国际 CFO 高永岗，长电科技 CEO 郑力等出席签约仪式。

会上，绍兴市政府、越城区政府分别与长电科技签订合作框架协议和落户协议。据悉，长电科技绍兴项目总投资80亿元，落户于越城区皋埠街道，将以集成电路晶圆级先进制造技术的应用为目标，计划导入国际一流的HDF0（高密度扇出封装）业务，拟建设成为国内最先进的封装测试基地，为芯片设计和制造提供晶圆级先进封装产品。项目一期规划总面积230亩，建成后可形成12英寸晶圆级先进封装48万片的年产能。二期规划总面积150亩，以高端封装产品为研发和建设方向，打造国际一流水平的先进封装生产线。

11月16日在中国（绍兴）第二届集成电路产业峰会上开幕式上，长电科技（绍兴）300毫米集成电路中道先进封装项目正式启动。



开幕式现场：长电科技绍兴项目正式启动

16日当天开幕式上，中芯国际重磅宣布，中芯绍兴项目顺利通线投片。该项目工厂是由中芯国际、绍兴市政府、盛洋集团共同出资筹建，这标志着中芯国际微机电和功率器件产业化项目正式落地绍兴，是绍兴集成电路小镇全产业链发展的关键性项目。

中芯绍兴项目总投资58.8亿元，该项目将建设一条集成电路8

英寸芯片制造生产线和一条模组封装生产线。未来将形成芯片年出货 51 万片和模组年出货 19.95 亿颗的产业规模，规模化量产麦克风、惯性、射频、MOSFET 以及 IGBT 等产品的芯片和模组。投入生产后可实现年产值 45 亿元。



开幕式现场：中芯国际绍兴项目通线投产

随着智能化社会的到来，人工智能、5G 通信、物联网、车载、工控等应用领域市场蓬勃发展。基于特色工艺的微机电系统是智能化的核心之一，但先进的微机电系统和功率器件芯片制造基地还是国内产业链的薄弱环节。而中芯绍兴的合资项目将面向微机电和功率器件集成电路领域，专注于晶圆和模组代工，持续投入研发并致力于产业化，将建设并形成一个综合性的特色工艺基地，快速占据国内市场领导地位。